

PLUS FIRMENVERZEICHNIS

Anmeldeformular

Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG
Karlstraße 4

D-88348 Bad Saulgau

Ihr Eintrag bietet in

übersichtlichen Rubriken
direkten Zugriff auf die Lieferanten und
auf mögliche Kunden

rund um die Elektronische Baugruppe.

Jeden Monat aktuell und mit einem Potenzial von ca. 4000 zukünftigen Kunden, Lieferanten und Herstellern, bietet das Firmenverzeichnis eine attraktive Kontakte-Plattform für die Leiterplatten- und Elektronikbranche in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden.

Füllen Sie bitte dieses Formular aus, kopieren Sie die nächste Seite, kreuzen Ihre gewünschten Rubriken an und senden beide Seiten an den

Eugen G. Leuze Verlag GmbH & Co. KG, per

Fax +49 7581 4801-10

per Mail (klaus.decker@leuze-verlag.de)

oder per Post an nebenstehende Adresse.

Hiermit erteilen wir den Auftrag zur Eintragung in das PLUS-FIRMENVERZEICHNIS (Preise pro Jahr):



Grundeintrag

- Eintrag in bis zu 3 Rubriken
- Anschrift und Kontaktdaten
- 12 Ausgaben pro Jahr

€ 370,-*



Zusatz- rubriken



Stk.

Pro Rubrik
und Jahr: € 96,-



Logo

schwarz
beim
Adress-
eintrag

€ 98,-



Logo

farbig
beim
Adress-
eintrag

€ 147,-

Ihr Eintrag:

Firmenname: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____ Fax: _____

E-Mail: _____ Internet: _____

Konditionen: Der Eintrag im Firmenverzeichnis läuft immer bis Ende eines Jahres. Danach verlängert es sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern nicht mit einer Frist von 6 Wochen zum Jahresende gekündigt wurde. Neben der Schriftform per Brief, können Sie uns auch bequem Ihre Abbestellung per E-Mail an buchbestellung@leuze-verlag.de zukommen lassen. Verspätet eingegangene Kündigungen können erst zum darauffolgenden

Jahresende berücksichtigt werden. Der Grundpreis beträgt 370,- € pro Jahr und beinhaltet den Eintrag in bis zu 3 Rubriken. Jede weitere Rubrik kostet zusätzlich 96,- € pro Jahr. Die Abrechnung erfolgt aus buchungstechnischen Gründen kalenderjährlich im Voraus. Redaktionsschluss für Änderungen ist jeweils der 15. des Vormonats vor dem Erscheinungstermin. Alle Preise verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Firmenstempel

Datum

Unterschrift

Kreuzen Sie hier Ihre Rubriken an:

1. Design

- Design-Dienstleister
- EDA Soft- u. Hardware
- Scannen u. Digitalisieren

2. Leiterplattentechnik

2.1 Hersteller

- Durchkontaktierte Leiterplatten/Multilayer
- HDI-Leiterplatten
- HF-Leiterplatten
- Leiterplattenhandel
- Nichtdurchkontaktierte Leiterplatten
- Prototypen und Muster
- Starrflexible und flexible Leiterplatten
- IMS und Dickkupferleiterplatten

2.2 Dienstleister

- Analysen
- Beratungsunternehmen
- Biegen, sicken, schneiden
- Bohren/Ritzen, Laserbohren
- CAM/Plotten
- Elektrischer Test
- Laserbearbeitung Flex-Leiterplatten
- Lohngalvanik, Endoberfläche
- Oberflächenbehandlung
- Plotten
- Prüfadapter Hersteller
- Recycling

2.3 Zulieferer

- Basismaterial für HF- und MW-Technik
- Basismaterial und Dielektrika, Kupferfolien
- Bohr- und Fräswerkzeuge
- Chemie für die Innenlagenoxidation
- Chemie für Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Chemie für Wasser- und Abwasserbehandlung
- Chemische Reiniger
- Entwickler-, Ätz- und Strippmedien
- Flexibles Basismaterial
- Galvano- u. Ätzresiste
- Hilfsmaterialien für Bohren/Fräsen & Verpressen
- Lötstopppresst und Hole Plugging

- Materialien für das Wärmemanagement
- Medien für die Endoberfläche
- Photo- und Presswerkzeuge

2.4 Maschinen u. Anlagen

- Absauganlagen für feste und gasförmige Stoffe
- Anlagenservice / Wartung
- Anlagen zur Wasser- aufbereitung und Abwassertechnik
- AOI- und AXI-Geräte
- Applikation des Lötstopplacks, Beschichtungslinien
- Belichter
- Bohr- & Fräsmaschinen, Ritzmaschinen
- Bond- und Nietsysteme zur Registrierung
- Bürsten, Entgraten
- DES-Anlagen
- Direktbelichter
- Durchkontaktierung und Leiterbilddaufbau
- Elektrischer Test
- Filtergeräte und -medien
- Gebrauchsmaschinen
- Innenlagenoxidation
- Kennzeichnung
- Kunststoffverarbeitung
- Laminatoren
- Laserbohrmaschinen
- Layupsysteme f. Multilayer
- Leiterplattenreparatur
- Multilayer-Pressen
- Messmaschinen/Scanner
- Oberflächenbehandlung
- Photoplotter
- Plasmabehandlung
- Pluggingmaschinen
- Pressblechreinigung/ Aufarbeitungsservice
- Pumpen
- Recycling von Materialien
- Reinigungsanlagen/-systeme
- Selektive Metallabscheidung
- Siebdruckanlagen
- Stromversorgungen
- Transport- und Handlingsgeräte
- Trocknungsanlagen

2.5 Software

- Impedanzberechnung
- Konstruktion und Dokumentation des Leiterplatten-/Multilayer-Aufbaus

3. Baugruppenteknik

3.1 Dienstleister

- Beratungsfirmen
- Bestückung
- BGA-Rework
- Coating
- Drahtbonden
- Eingabesysteme aus Glas
- Geräteentwicklung
- Gerätemontage
- Kabelkonfektionierung
- Komplettservice
- Prototypen
- Qualitäts- und Prozesskontrollen
- Reinigungsprozess
- Reparatur- und Reballingschablonen
- Schablonen-Spannsysteme
- SMD-Schablonen
- Substratintegration
- Test/Prüfung
- Unterfüllung
- Vereinzeln von Flex-Schaltungen
- Verguss

3.2 Bauteile- und Werkzeuglieferanten

- Druck-Unterstützungswerkzeuge
- Lötmasken / Warenträger
- Steckverbinder und Fassungen/elektromechanische Komponenten
- Testadapter

3.3 Materialzulieferer

- Gießharze, Vergussmassen, Unterfüller- und Glob Top-Materialien
- Klebstoffe, SMD-/Chip-Kleber, elektrisch und thermisch leitfähige Klebstoffe, Wärmeleitpasten
- Lote, Lotpasten, Flussmittel, Lötformteile
- Reinigungsmedien und -materialien
- Schutzlacke

3.4 Maschinen u. Anlagen

- AOI, AXI und Mikroskope
- Aushärte-/Trockenöfen
- Bestückungsgeräte und -automaten
- Bügellöt- und Widerstandsschweißgeräte
- Dispenser / Dosiergeräte
- ESD-Schutzeinrichtungen und -zubehör
- Gebrauchsmaschinen
- Incircuit / Funktionstester

- Kennzeichnungs- und Identifikationsgeräte
- Lötanlagen und -geräte
- Lotpasteninspektion
- Pastendrucker
- Reinigungsanlagen
- Schutzbeschichtungsanl.
- Temperaturprofiler
- Transport- und Handlingsgeräte

3.5 Software

- Fertigungssoftware
- Traceability / MES

4. Packaging/Embedding Hybridtechnik

4.1 Hersteller

- 3D-MID
- Chipgehäuse und Module
- Dickfilmschaltungen
- Hermetisch dichte Sockel/Gehäuse
- Mehrlagenkeramikschaltungen

4.2 Zulieferer

- Bonddraht
- Dickfilmpasten
- Drucksiebe
- Keramiksubstrate

4.3 Maschinen u. Anlagen

- Aushärteanlagen
- Ball Placement Masch.
- Die- und Chipmontagegeräte und -systeme
- Dispenser / Dosiergeräte
- Drahtbonden
- Gebrauchsmaschinen
- Nasschemische Anlagen für stromlose Ni/Au Metallisierung
- Prüfgeräte
- Reinraumeinrichtungen und -zubehör
- Sieb- und Schablonendruckgeräte
- Trimmlaser
- Trocken- / Einbrennöfen

4.4 Dienstleister

- Einbetttechnik
- Wafer Bumping

5. Zuverlässigkeit

- Qualifizierung
- Zuverlässigkeitsunters.

6. SMD / THT Bauteile

- Logistik
- Tape und Reel Service